ชื่อวิทยานิพนธ์ การเตรียมและสมบัติของอีพ็อกซีคอมโพสิทที่อบด้วยเตาไมโครเวฟ

ผู้เขียน นายคำรง เจริญดี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของอีพ๊อกซีเส้นใยแก้ว คอมโพสิทที่อบด้วยความร้อนและอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ ชนิดของอีพ็อกซีที่ใช้ได้แก่ ไดไกลซิดิล อีเทอร์ บิสฟินอล-เอ สารช่วยทำให้แข็งตัวที่ใช้เป็นกลุ่มแอนไฮไครค์ได้แก่ เมทิลเตตระไฮโครฟา ทาลิกแอนไฮไดรด์ และเมทิลเฮกซะไฮโดรฟาทาลิกแอนไฮไดรด์ ผสมอีพ๊อกซีกับสารช่วยทำให้ แข็งตัวในอัตราส่วน 100:80 โดยน้ำหนัก เส้นใยแก้วที่ใช้เป็นชนิดเส้นใยสานแบบสุ่ม ปริมาณเส้น ใยแก้วที่ใช้ประมาณ 15% โดยน้ำหนักของคอมโพสิท อบอีพ๊อกซีด้วยเตาอบความร้อนที่อุณหภูมิ 150° C เป็นเวลา 15 min และ 25 min ตามปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้คือ 1% และ 4% โดยน้ำหนัก ของอีพ๊อกซี ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้กือไคเมทิลอะมิโนเมทิลฟีนอล และเบนซิลไคเมทิลเอมีน ไมโครเวฟที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นชนิดที่ใช้ในครัวเรือน ออกแบบการอบอีพ๊อกซีที่ระดับความร้อน ต่างๆ โดยแบ่งเป็นการอบโดยใช้ระดับความร้อนเดียว (1S), สองระดับความร้อน (2S) และสาม ระดับความร้อน (3S) สมบัติเชิงกลที่ศึกษาได้แก่ สมบัติการต้านแรงดึง สมบัติการคัดโค้ง และ สมบัติการต้านแรงกระแทกทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3039, D790 และ D256 ตาม ลำดับ วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิก TGA, DMTA และ SEM ผลการทคลองแสดงให้เห็นว่าอื่ พ๊อกซีบางสูตรที่อบด้วยเตาไมโครเวฟแบบ 1S ให้ก่าสมบัติเชิงกลบางค่าสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับอีพี อกซีที่อบค้วยเตาอบความร้อน ส่วนการอบแบบ 2S และ 3S นอกจากจะให้สมบัติเชิงกลบางค่าที่ดี กว่าการอบด้วยเตาอบความร้อนแล้วยังให้สมบัติทางกายภาพที่ใกล้เกียงกับการอบด้วยความร้อน ด้วย ผลวิเคราะห์ของ TGA แสดงให้เห็นว่าอีพ๊อกซีที่อบแบบ 2S และ 3S มีเสถียรภาพทางความ ร้อนสูงกว่าการอบแบบ 1S ผลของ SEM แสดงให้เห็นว่าการอบแบบ 2S และ 3S มีการยึดเกาะ ระหว่างอีพ๊อกซีที่ผิวของเส้นใยแก้วดีกว่าการอบแบบ 1S และการอบด้วยเตาอบความร้อน แต่ผล ของ DMTA แสดงให้เห็นว่าการอบด้วยความร้อนให้ค่า $\mathbf{T}_{_{\! \mathrm{L}}}$ ที่สูงกว่าการอบด้วยเตาไม โครเวฟ นอก จากนี้การอบในเตาไมโครเวฟใช้เวลาในการอบจริงเพียง 20 - 40% ของเวลาที่ใช้ในการอบด้วยเตา อบความร้อน

Thesis Title Preparation and Properties of Epoxy Composite Cured with Microwave

Oven

Author Mr.Dumrong Jaroendee

Major Program Polymer Science and Technology

Academic Year 2005

ABSTRACT

The objective of this work was to compare the mechanical properties of epoxyglass fiber composites cured by thermal heating and microwave heating. Epoxy resin was a diglycidyl ether of bisphenal - A. Methyl tetrahydrophthalic anhydride and methyl hexahydrophthalic anhydride were used as a curing agent. Accelerators included tris-2,4,6dimethylaminomethyl phenol and benzyldimethylamine. Chopped strand mat glass fiber with specific weight of 0.03 g/cm² was employed. Weight ratio of epoxy:curing agent was 100:80. Thermal curing was performed at 150°C for 15 and 25 min for composites containing 1% and 4% accelerator, respectively. Microwave curing was carried out at various conditions, including 1step, 2-step and 3-step heating cycle, whereby each cycle employed different power level and time. Tensile properties, flexural properties (three-point bending) and notched Izod impact resistance were tested according to ASTM standards. It is found that the 1-step microwave-cured composites showed mechanical properties as good as the thermally cured composites. The composites obtained from 2-step and 3-step heating cycle in the microwave curing process produced mechanical properties higher than those obtained from the 1-step microwave curing and thermally curing process. Thermogravimetric analysis showed that thermal stability of resins obtained from 2-step and 3-step curing processes was higher than that from the 1-step process. Scanning electron micrographs showed that 2-step and 3-step curing processes yielded higher matrix-fiber adhesion than thermally and 1-step curing processes. The very low power level in the microwave oven at the first step of curing caused slow increase in viscosity at the beginning of the multi-step process. This is resulted from the slow rate of temperature increment in the resin. Effective cure time in the microwave oven was approximately 20-40% of cure time in the thermal oven.